

## 合作研究計畫名稱：終端裝置複合訊號分析之軟硬體整合開發與驗證

### 徵求對象：

1.本計畫執行需具備下列相關技術領域知識：

- 知器軟硬體設計技術
- 藍芽通訊等相關技術
- 訊號分析技術
- 機器學習技術

2.學界：

限於符合下列各項條件者：

- 2.1.全國公私立大專院校（含）以上之學術機構。
- 2.2.擁有技術能力及足以從事合作研究人力與設備。
- 2.3.本公告之「合作研究計畫名稱」關於各計畫之 RFP 規定之其他條件。